PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-176994

(43)Date of publication of application: 24.06.1994

(51)Int.CI.

H01L 21/02

(21)Application number: 05-050432

(71)Applicant:

TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

11.03.1993

(72)Inventor:

OZAKI YUUICHIROU

FUKUDA ETSUO

(30)Priority

Priority number: 04269987

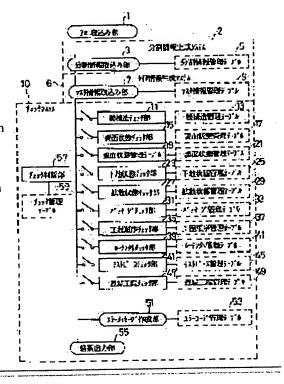
Priority date: 08.10.1992

Priority country: JP

(54) MANUFACTURING-RULE CHECK SYSTEM

(57) Abstract:

PURPOSE: To check a huge and complicated process flow at high speed. CONSTITUTION: A process flow which has been formed is preserved in a recording medium as information for a computer. Before the rule of the preserved process flow is checked, a pattern dividing operation by division information on a flow when a division exists is performed by a division-information generation system 2. A mask-information control table 9 which controls in which part on the surface of a product a resist is to be applied on the basis of dimensional information on a mask pattern in a lithographic process and on the basis of resist information is formed by a layer-information generation system 6. By using several tables 53, 59 which have been prepared in the recording medium in advance and by using tables 13 to 49 which are formed during a check operation, the process flow is checked in individual check parts 11 to 47. Thereby, the title system can be utilized simply by everybody as a common knowledge, and a check error is reduced.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.04.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3202388

[Date of registration]

22.06.2001

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平6-176994

(43)公開日 平成6年(1994)6月24日

(51) Int.Cl.⁸

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

H01L 21/02

Z

A

審査請求 未請求 請求項の数10(全 20 頁)

(21) 出願書号

特勵平5-50432

(22)出題日

平成5年(1993)3月11日

(31) 優先権主張書号 特顯平4-269987

(32) 優先日

平4 (1992)10月8日

(33)優先権主張図

日本 (JP)

(71)出版人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 尾崎 雄市郎.

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会

社東芝研究開発センター内

(72)発明者 福田 悦生

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会

社東芝研究開発センター内

(74)代理人 井理士 三好 秀和 (外1名)

(54) 【発明の名称】 製造規則チェックシステム

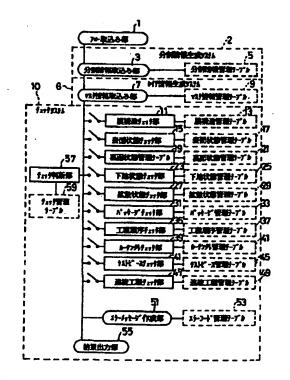
(57)【耍約】

(修正有)

【目的】 長大で複雑なプロセスフローを高速でチェッ クする。

作成されたプロセスフローをコンピュータの 情報として記録媒体に保存する。保存されたプロセスフ ローのルールチェックを行う前に、分割が存在した場合 のフローの分割情報によるパターン分けを分割情報生成 システム2で行う。リソグラフィ工程におけるマスクバ ターンの寸法情報、レジスト情報より製品表面上のどの 部分にレジストがのるか、のらないかについてを管理す るマスク情報管理テーブル9をレイア情報生成システム 6で作成する。記録媒体に予め用意した幾つかのテープ ル53,59、及びチェック中に作成する幾つかのテー プル13~49を用いて各チェック部11~47でプロ セスフローのチェックを行う。

【効果】 誰でも簡単に共通の知識として利用できるよ うになり、チェックミスが減少する。



【特許請求の範囲】

【酵求項1】 複数の製造工程を有し、異なる工程順序 と製造条件を持つ多品種変量製造ラインにおける製造規 則をチェックするシステムであって、

外部記憶装置に保存されている製造規則情報をメインメ モリ上に取込む手段と、

取込まれた製造規則情報に、製品を分割処理すべき分割 工程が存在するかどうかをチェックし、分割工程が存在 した場合に製品番号毎に製造規則情報の分類を行い分割 情報を生成する分割情報生成手段と、

リソグラフィエ程で用いられるマスクパターンの、寸法 情報、レジスト有無情報をまとめたマスク情報管理デー ブルをメインメモリ上に取込み、取込まれた情報よりレ イア情報を生成するレイア情報生成手段と、

製品表面や裏面上に地積されている膜構造を管理する膜構造を管理する膜

この膜構造管理テープルを用いて製造規則情報のエッチング工程に書かれた削る膜の構造と実際製品上に堆積されている膜の構造が等しいかをチェックする膜構造チェック手段と、

製品表面に露出している膜によって、行える工程。行えない工程をまとめた表面状態管理テープルと、

この表面状態管理テーブルを用いてチェックする表面状態チェック手段と、

製品裏面に開出している膜によって、行える工程、行えない工程をなどめた裏面状態管理テーブルと、

この裏面状態管理デーブルを用いてチェックする裏面状態チェック手段と、

製品の表面上に存在する膜によって、行える工程、行えない工程をまとめた下地状態管理テーブルと、

この下地状態管理テープルを用いてチェックする下地状態チェック手段と、

拡散炉の汚染度によってランク分けを行い、それをまと めた拡散状態管理テーブルと、

この拡散状態管理テーブルを用いてチェックする拡散状態チェック手段と、

ある工程からある工程までの範囲のなかで行える工程、 行えない工程をまとめたパッケージ管理テープルと、 このパッケージ管理テーブルを用いてチェックするパッ ケージチェック手段と、

規定された製造工程順序をまとめた工程順序管理テープ ルト

この工程順序管理テーブルを用いてチェックする工程順 序チェック手段と、

行ってはいけない工程、ある工程の後で行ってはいけない工程をまとめたルーチン外工程管理テーブルと、

このルーチン外工程管理テーブルを用いてチェックする ルーチン外工程チェック手段と、

試験用製品の挿入位置、抜き取り位置、種類をまとめた試験用製品管理テーブルと、

この試験用製品管理テーブルを用いてチェックする試験 用製品チェック手段と、

連続工程のパターンをまとめた連続工程管理テーブル と.

この連続工程管理テーブルを用いてチェックする連続工程チェック手段と、

エラーメッセージをまとめたエラーコード管理テープルと、

このエラーコード管理テーブルを用いてエラーメッセー 10 ジを作成するエラーメッセージ作成手段と、

前配各チェック手段によるチェックを行うかどうかをま とめたチェック管理テープルと、

このチェック管理テープルを用いてチェックを行うかど うかを判断するチェック判断手段と、

チェック結果を出力する出力手段とを具備したことを特 徴とする製造規則チェックシステム。

【前求項2】 前記分割情報生成手段は、製品番号毎の 分割情報を作成した後に同一処理される製品を単位とし てグルーピングを行うことを特徴とする請求項1配載の 根造規則チェックシステム。

【請求項3】 前配分割情報生成手段は、前配製造規則 情報に分割工程が何工程含まれるかを数える手段と、そ の分割工程に含まれる分割数、分割枚数、及び分割製品 番号を取り込む手段を有することを特徴とする請求項1 配載の製造規則チェックシステム。

【蔚求項4】 前記膜構造チェック手段、表面状態チェック手段、裏面状態チェック手段、及び下地状態チェック手段は、製品が出来る過程をシミュレートしつつ、前配膜構造チェック手段及びその製品に付随する製造規則情報を用いながらチェックを行う事を特徴とする請求項1配載の製造規則チェックシステム。

【請求項5】 前配膜構造チェック手段、表面状態チェック手段、及び下地状態チェック手段は、前配レイア情報生成手段によって生成されたレイア情報を用いて、製品の複数のレイア状態を一度にチェックすることを特徴とする請求項1記載の製造規則チェックシステム。

【簡求項6】 前記チェック判断手的は、チェックを行う前にチェックを行うチェック手段を選択する事を特徴とする請求項1 記載の製造規則チェックシステム。

② 【請求項7】 前記レイア情報生成手段は、マスク情報 取込み部と、マスク情報管理テーブルと、レイア情報生 成部と、機能選択部と、レイア情報受波し部と、マスク 情報生成部とからなることを特徴とする請求項1配款の 製造規則チェックシステム。

【請求項8】 前配レイア情報生成手段は、CADシステムから得られる設計図の長さ、レジスト有無情報から、各設計図面毎のレイア情報を生成する事を特徴とする請求項1記載の製造規則チェックシステム。

【請求項9】 前記レイア情報生成手段によって生成さ 50 れたレイア情報を、前記機構造管理テーブルに2次元で

--530-

格納することを特徴とする静水項1記載の製造規則チェ ックシステム。

【請求項10】 前記レイア情報生成手段によって生成 されたレイア情報を、半導体製造におけるプロセス/デ パイス/形状シミュレータ等の2次元、3次元計算に用 いることを特徴とする請求項1配載の製造規則チェック システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、複数の製造工程を有 10 し、異なる工程順序と処理(製造)条件を持つ多数の被 生産対象を同時に製造・処理を行う多品種変量製造ライ ンにおける処理の流れ(製造規則/以下、プロセスフロ ーという)をチェックする製造規則チェックシステムに 関するものである。

[0002]

【従来の技術】技術者・研究者あるいはコンピュータが 組んだプロセスフローは必ずしも正しいとは腱らない。 例えば、図39に示すプロセスフローは、工程番号5の ならない。また、工程番号3のアルミニウムスパッタエ 程の後に、SH処理は指定できない等のミスがある。

【0003】従来、これら処理の流れは、プロセス/デ パイスの熟練者(エキスパート)により行われていた。 しかし、技術者/研究者のプロセスフロー作成人数およ び、プロセスフロー数に対して、チェックを行う熟練者 の数が不足しており、熟練者が1日の多くの時間をチェ ックの対応に迫いれているのが現状である (おおよそ3) 00工程の処理の流れをチェックするのに約30分を要

【0004】また、チェックを行う熟練者になるには長 年のプロセス/デバイスの経験と知識がなければなら ず、簡単にはプロセスフローをチェックする人数を増や すことはできない。さらに、熟練者の知識・経験・ノウ ハウといったものが必ずしも正確に受け離がれることは 難しく、熟練者個人の所有となっているのが現状であ る。さらに、今後益々処理の流れは長くなる傾向にあ り、熟練者といえどもチェックに対するミスが生じ易く なることが予想される。

【0005】また、プロセスフローは、ある変換手段を 40 用いて、プロセスシミュレータやデパイスシミュレー タ、形状シミュレータへ情報を受渡し、計算することが できる。しかし、プロセスフローにはリソグラフィ工程 の設計情報(マスク情報)が不足していたため、プロセ スフロー転送前後に、技術者は計算を行いたい層(レイ ア)の情報のみを選択し、計算を行っていた。つまり、 シミュレータにおける計算は1次元のみしか自動転送で きなかった。

【0006】また、技術者・研究者がプロセスフローを

は、同じ製造工程を違う条件で処理を行なう場合が多々 ある。そのプロセスフローをチェックする場合は、各々 の製品についてその製品数分の情報を持ち、それについ て個々にチェックを行っていた。すなわち条件の具なる 製品数が24であった場合は24個分の情報を持たなけ ればならない。その結果、チェックを行なう場合、その 都度分割工程を管理しながらチェックを行わなければな らないので、チェックシステムが複雑になり、チェック 速度が遅くなってしまう。

【0007】また、同じ条件で処理されている製品が複 数存在した場合、それについてもいちいちチェックを行 わなければならず、チェック時間が大幅にかかってしま う。更にチェックを行う際に用いる1つの情報が大きく なるとメモリが足りなくなる問題が発生する可能性があ り、マスク情報を取り込むとチェックを行う為の製品1 つの情報が更に大きくなり、システムがメモリ不足をお こし、実行不可能となってしまうことがあった。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】 上記のように、プロセ リソグラフィ工程の後に本当ならば検査工程が無ければのカースの流れをチェックする場合、人間ではミスが無いとは 限らない。さらに、チェックに多くの時間を必要とす る。また、プロセスフローの工程数が増加し、近い将来 必ず人間の限界がおとずれることが予想される。

> 【0009】また、プロセスフローには設計情報(マス ク情報)が含まれていなかったため、プロセス/デバイ ス形状シミュレータでは、プロセスフローは1次元のみ を扱い、2次元、3次元のシミュレーションを行うこと ができなかった。

【0010】本発明は、この様な問題を解決し、長大か 30 つ複雑なプロセスの流れをより高速でチェックできる製 造規則チェックシステムを提供することを目的とする。

【0011】また、本発明は、プロセスフローに設計情 報を付加することで、2次元、3次元のプロセス/デバ イス/形状シミュレータ用のプロセスフロー情報を生成 することができる製造規則チェックシステムを提供する ことを目的とする。

【0012】更に、本発明では、多品種変量製造ライン の為のプロセスフローを効率的にチェックできる製造規 則チェックシステムを提供することを目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】上記課題を達成するため に、本発明は、複数の製造工程を有し、異なる工程順序 と製造条件を持つ多品種変量製造ラインにおける製造規 則をチェックするシステムであって、外部配憶装置に保 存されている製造規則情報をメインメモリ上に取込む手 段と、取込まれた製造規則情報に、製品を分割処理すべ き分割工程が存在するかどうかをチェックし、分割工程 が存在した場合に製品番号毎に製造規則情報の分類を行 い分割情報を生成し、製品番号毎の分割情報を生成した 組む場合、完成された処理(プロセス)の流れの中に *50* 後に同一処理される製品を単位として分類を行う分割情

報生成手段と、リソグラフィ工程で用いられるマスクバ ターンの、寸法情報、レジスト情報をまとめたマスク情 報管理テーブルをメインメモリ上に取込み、取込まれた 情報よりレイア情報を生成するレイア情報生成手段と、 前記レイア情報生成手段によって生成されたレイア情報 から製品表面や裏面上に堆積されている膜構造を2次元 で管理する膜構造管理テーブルと、この臓構造管理テー ブルを用いて製造規則情報のエッチング工程に書かれた 削る膜の構造と実際製品上に地積されている隣の構造が - 等しいかをチェックする膜構造チェック手段と、製品表 10-面に露出している膜によって、行える工程、行えない工 程をまとめた表面状態管理テーブルと、この表面状態管 理テーブルを用いてチェックする表面状態チェック手段 と、製品裏面に郵出している膜によって、行える工程、 行えない工程をまとめた裏面状態管理テーブルと、この 裏面状態管理テーブルを用いてチェックする裏面状態チ エック手段と、製品の表面上に存在する膜によって、行 える工程、行えない工程をまとめた下地状態管理テープ ルと、この下地状態管理テーブルを用いてチェックする 下地状態チェック手段と、拡散炉の汚染底によってラン 20 ク分けを行い、それをまとめた拡散状態管理テーブル と、この拡散状態管理テーブルを用いてチェックする拡 散状態チェック手段と、ある工程からある工程までの範 囲のなかで行える工程、行えない工程をまとめたパッケ ージ管理テープルと、このパッケージ管理テープルを用 いてデェックするパッケージチェック手段と、規定され た製造工程順序をまとめた工程順序管理テーブルと、こ の工程順序管理テーブルを用いてチェックする工程順序 チェック手段と、行ってはいけない工程、ある工程の後 で行ってはいけない工程をまとめたルーチン外工程管理 30 テーブルと、このルーチン外工程管理テーブルを用いて チェックするルーチン外工程チェック手段と、試験用製 品の挿入位置、抜き取り位置、種類をまとめた試験用製 品管理テーブルと、この試験用製品管理テーブルを用い てチェックする試験用製品チェック手段と、連続工程の パターンをまとめた連続工程管理テーブルと、この連続 工程管理テーブルを用いてチェックする連続工程チェッ ク手段と、エラーメッセージをまとめたエラーコード管 理テーブルと、このエラーコード管理テーブルを用いて エラーメッセージを作成するエラーメッセージ作成手段 40 と、前配各チェック手段によるチェックを行うかどうか をまとめたチェック管理テーブルと、このチェック管理 テープルを用いてチェックを行う前にチェックを行うチ エック手段を選択するチェック判断手段と、チェック結 果を出力する出力手段とから構成されている。

【0014】また前記膜構造チェック手段、表面状態チ エック手段、裏面状態チェック手段、及び下地状態チェ ック手段は、製品が出来る過程をシミュレートしつつ、 前配膜構造チェック手段及びその製品に付随する製造規

前記良構造チェック手段、表面状態チェック手段、及び 下地状態チェック手段は、前配レイア情報生成手段によ って生成されたレイア情報を用いて、製品の複数のレイ ア状態を一度にチェックすることを特徴としている。

【0015】また前記レイア情報生成手段は、マスク情 報取込み部と、マスク情報管理テープルと、レイア情報 生成部と、機能選択部と、レイア情報受渡し部と、マス ク情報生成部とから構成され、CADシステムから得ら れる設計図の長さ、レジスト有無情報から、各設計図面 毎のレイア情報を生成する事を特徴としている。

【0016】さらに、本発明は前配レイア情報生成手段 によって生成されたレイア情報を、半導体製造における プロセス/デバイス/形状シミュレータ箏の2次元、3 次元計算に用いることを特徴としている。

【0017】さらに前配分割情報生成手段は、前記製造 規則情報に分割工程が何工程含まれるかを数える手段 と、その分割工程に含まれる分割数、分割枚数、及び分 割製品番号を取り込む手段を有することを特徴としてい る.

[0018]

【作用】上記手段により、本発明では、作成されたプロ セスフローを、コンピュータの情報としてフロッピーデ ィスクやハードディスクに代表される記録媒体に保存す る。次に、保存されたプロセスフローに対して、チェッ クを行う前に、分割が存在した場合のフローの分割情報 によるパターン分けを分割情報生成手段で行い、CAD システムより生成されるマスク情報を基にレイア情報生 成手段でレイア情報を生成し、プロセスフロー情報に付 加する.

【0019】この後、コンピュータの配録媒体、例えば ハードディスクにあらかじめ用意した幾つかのテープ ル、およびチェック中に作成する幾つかのテーブルを用 いながら、レイア情報が付加されたプロセスフローのチ エックを前配各チェック手段で行っている。

[0020]

【実施例】以下、図面に基づいて本発明の実施例を説明 する.

【0021】図1はこの発明の製造規則チェック(以 下、プロセスフロールールチェックという)システムに 係わる一実施例の機能プロック図である。

【0022】同図に示すプロセスフローチェックシステ ムは、大きくはプロセスフロー取込み部1、分割情報生 成システム2、レイア情報生成システム6、及びチェッ クシステム10からなる。分割情報生成システム2は、 分割情報取込み部3と分割情報管理テーブル5から構成 され、レイア情報生成システム6は、マスク情報取込み 部7とマスク情報管理テーブル9から構成されている。

【0023】また、チェックシステム10は、各管理テ ープル13~53、各チェック部11~47、エラーメ 則情報を用いながらチェックを行う事を特徴とし、かつ 50 ッセージ作成部51、及び結果出力部55、チェック判

断部57、チェック管理テーブル59から構成されてい る.

【0024】プロセスフロー取込み部1は、半導体製造 工程の流れを各々の工程の処理条件(レシビ)で表され た情報(プロセスフロー情報)、例えば、半海体製造工 程を表すコード、各処理に付随する変数、およびその変 数に代入するパラメータ(変数の値)などによって表さ れたプロセスフロー情報を配像装置(例えばハードディ スク) よりコンピュータのメインメモリ上に取込む機能 を有している。

【0025】分割情報生成システム2は、これからチェ ックを行うプロセスフロー情報において、分割工程が存 在しているかどうかのチェックを行う機能と、後述する 分割情報管理テーブル5を作成する機能を有している。

【0026】分割工程が存在した場合は、そこに書かれ ている分割数、各々の分割における製品枚数、製品番号 の情報より製品毎にどの分割プロセスフロー情報を用い るかについて分類を行い、更に同一プロセスフローで処 理される製品を単位としてグルーピングを行う。その結 果を落に分割情報管理テーブル5を作成し、分割工程を 20 含まない新たなプロセスフロー情報を作成する機能をも 有している。

【0027】分割情報管理テーブル5は、製品番号毎に 分割工程において、どの分割プロセスフロー情報を用い るかを管理するテーブルである。ここで、分割工程と は、半導体製造における製品は、複数の製品がまとまっ て1つのロットと呼ばれる箱に格納されて処理が行われ ている。

【0028】このため、ロットに入っている複数の製品 のうち、数枚を別のプロセスフロー情報で製造したい場 30 合、ロット内の製品を分けて製造する事がある。このロ ットを分割して、ある処理の条件を複数に分けて行う場 合に用いる。

【0029】例えば、プロセスフロー情報において、製 品番号=(1, 2, 3)が本来のプロセスフロー情報で 処理し、製品番号= (4, 5, 6) が分割で処理を行う 場合、この情報が、分割情報管理テーブル5に配述され る。ただし、製品が1枚(個)の場合にその製品内を分 割し処理を行う場合にも、この機能は適用することがで

【0030】レイア情報生成システム6は、詳細は後述 するが、配憶装置に予め取込まれているマスク情報を取 り込む機能と、後述するマスク情報よりレイア情報を作 成する機能を有している。マスク情報とは、マスク設計 用CADなどより与えられるパターンの寸法情報や、レ ジストが残るか否かのレジスト情報などである。

【0031】更に、このレイア情報生成システム6はマ スク情報を基に、作成されるレイア情報をマスク情報管 理テーブル9に格納する機能を有している。 また、この 分けられたレイアの数は、後述する製構造管理テーブル 50 処理 a を行う事はNGである事がチェックできる。

13に使われる。

【0032】図1の各チェック部11~47は、プロセ スフロー情報をチェックする機能を有している。これら のチェック部11~47は、チェック判断部57でチェ ック機能を付加するかしないかを指示することができ る。以下にそれぞれのチェック部11~47、各管理テ ープル13~53、チェック判断部57、チェック管理 テーブル59について説明をする。

8

【0033】膜構造チェック部11では、プロセスフロ 10 一情報の膜を削る工程に記述されている膜を削る時間を 計算する為の膜構造と、実際の製品上に堆積されている 膜構造とが等しいかどうかをチェックする機能を有して いる。また、製品上に堆積されている膜は、膜構造管理 テープル13において管理されている。

【0034】例えば、図2に示すプロセスフロー情報、 すなわち、アルミニウム膜と酸化膜を削る工程におい て、エッチングする膜構造はアルミニウム膜と酸化膜と なるが、実際製品上にはアルミニウムニウム膜のみが堆 積されている事が、図3に示す誤構造管理テーブル13 より取得する事ができ、エッチング工程での関構造とウ エハ上に堆積されている膜と違う為、NGである事がチ エックされる。

【0035】膜構造管理テーブル13は、ウェハ表面、 裏面上に堆積されている膜を管理する為のテープルであ る。何えば何も堆積されていないウエハを酸化した場 合、ウエハ表面、真面には、酸化膜が堆積されるので、 順構造管理テーブル13に酸化膜が追加される。

【0036】この膜構造管理テーブル13は、レイア情 報生成システム6で分けられたレイア数に応じたデータ を格納する。図4に示した例では、レイアが酸化膜であ り、レイア数は1である。

【0037】表面状態チェック部15は、製品の表面に 郵出している僕によって、処理できる工程、出来ない工 程を膜構造管理テープル13を用いてチェックする機能 を有している。また、このチェックに関するルールは表 面状態管理テーブル17において管理されている。

【0038】図5に示す表面状態管理テーブル17にお いて、上の機軸には、製品表面上に存在する可能性があ る膜の名称、左の縦軸には、行われる可能性のある工程 名が記入してある。

【0039】例えば、図6に示した製品表面上にAとい う膜が舞出している状態で、処理αを行う場合と、処理 bを行う場合を考えると、図5に示す表面状態管理テー プル17によって、製品表面にAという膜が貫出してい る状態で、処理aを行う場合はOKであるが、処理bを 行う場合はNGである事がチェックできる。

【0040】また、図7に示す様に製品表面に膜A、B が出ている場合でも、図5に示す表面状態管理テーブル 17において、製品表面上に膜Bが露出している状態で

るルールは、パッケージ管理テーブル33において管理 されている.

10

【0041】裏面状館チェック部19は、製品の裏面に 第出している膜によって、処理できる工程、出来ない工 程を膜構造管理テープル13を用いてチェックする機能 を有している。また、このチェックに関するルールは、 裏面状態管理テーブル21において管理されている。

【0042】図8に示した裏面状態管理テーブル21に おいて、上の機軸には、製品裏面上に存在する可能性が ある膜の名称、左の縦軸には、行われる可能性のある工 程名が配入してある。

【0043】例えば、図9に示した製品裏面上に膜Cが 10 舞出している状態で、処理α、処理bを行う場合を考え ると、図8に示した裏面状態管理テーブル21によっ て、製品裏面にCという膜が露出している状態で、後に 処理aがくる場合はOKであるが、後に処理bがくれば NGである事がチェックできる。

【0044】下地状態チェック部23は、ウェハ上に堆 積されている膜によって、 処理できる工程、 出来ない工 程を段構造管理テーブル13を用いてチェックする機能 を有している。また、このチェックに関するルールは、 下地状態管理テーブル25において管理されている。

【0045】図10に示した下地状態管理テーブル25 において、上の債骸には、下地の存在する可能性がある 膜の名称、左の縦軸には、行われる可能性のある工程名 が記入してある。

【0046】例えば、図11に示した、製品上に脱A、 B、Cが堆積されている状態で、処理bを行う場合を考 えると、図10に示した下地状態管理テーブル25によ って、下地にCという膜が存在している状態で、後に処 理りがくればNGである事がチェックできる。

【0047】拡散状態チェック部27は、汚染されてい 30 る拡散炉に入った製品が、綺麗な拡散炉に入る事を防ぐ ため、すなわち拡散炉の汚染を防ぐチェックを行う機能 を有している。また、このチェックに関するルールは、 拡散状態管理テーブル29において管理されている。

- 【0048】図12に示した拡散状態管理テーブルにお いて、上の横軸には、1つ前に製品が入った拡散炉の名 称、左の縦軸には、これから入ろうとする拡散炉の名称 が記入されている。

【0049】例えば、図13に示した製品は、拡散炉D に入った製品であるが、この製品が次に拡散炉E、もし 40 くは拡散炉下に入る場合を考えると、図12に示した拡 散状態管理テーブル29によって、拡散炉Dに入った製 品が拡散炉Eに入る場合はOKであるが、拡散炉Fに入 る事はNGである事がチェックできる。

【0050】パッケージチェック部31は、ある工程 (A) とある工程 (B) を1つのパッケージとして、そ のパッケージ内(A、B間)に存在しなければならない 工程、存在してはいけない工程、ある工程が存在した場 合、更にある工程が存在しなければならない様なチェッ クを行う機能を有している。また、このチェックに関す 60 という事で、NGである事がチェックされる。

【0051】図14に示したパッケージ管理テープル3 3において、上の横軸には、パッケージの基になる工程 の名称、バッケージ内の存在しなければいけない工程 名、パッケージ内の存在してはいけない工程名、パッケ ージ内に存在した場合、更に存在しなければならない工 程名、エラーコードが記入されている。

【0052】例えば、図15に示したプロセスフロー情 報、すなわち、リソグラフィエ程とレジスト剥離工程と の間に熱酸化工程が存在した場合を考えると、図14に 示したパッケージ管理テープル33によって、製品上に フォトレジストが独布されている状態で酸化炉に入れる 事はNGである事がチェックできる。

【0053】また、図16に示したプロセスフロー情報 すなわち、リソグラフィ工程とリソグラフィ工程の間 に、レジスト剥離工程が存在しない場合を考えると、図 14に示したパッケージ管理テーブル33によって、レ ジスト剥離工程が存在しないという事でNGである事が 20 チェックできる。

【0054】工程順序チェック部35は、ある工程の前 に存在しなければならない工程、ある工程の後に存在し なければならない工程、ある工程の前に存在してはいけ ない工程、ある工程の後に存在してはいけない工程につ いてチェックを行う機能を有している。また、このチェ ックに関するルールは、工程順序管理テーブル37にお いて管理されている。

【0055】図17に示した工程順序管理テーブル37 において、上の横輪には、検索元となる工程名、検索先 となる工程名、検索先となる工程名の位置、検索先の工 程が存在しなければならないのか、存在してはいけない のか、エラーコードが配入される。

【0056】例えば、図18に示したプロセスフロー情 報、すなわち熱酸化工程の前に洗浄処理が存在しなかっ た場合を考えると、図17に示した工程順序管理テープ ル37によって、熱酸化工程の前に洗浄処理が存在して いないという事でNGである事がチェックされる。

【0057】ルーチン外チェック部39では、プロセス フロー情報において、処理を行う為に作業者の許可を必 要とする工程をチェックする機能を有している。 また、 このチェックに関するルールは、ルーチン外管理テープ ル41において管理されている。

【0058】図19に示したルーチン外管理テーブル4 1において、上の横軸には、検索元となる工程名、検索 先となる工程名、エラーコードが配入されている。 例え ば、図20に示したプロセスフロー情報、すなわち、配 線の抵抗率を測定する工程が存在した場合を考えると、 図19に示したルーチン外管理テーブル41によって、 配線の抵抗率を測定する工程は許可が必要な工程である

【0059】テストピースチェック部43では、製品に 膜を堆積した時の膜厚、イオン注入を行った時の製品の 抵抗率を測定する為のテストピース(TP/試験用製 品)の挿入位置、TPの種類のチェックを行う機能を有 している。また、このチェックに関するルールは、テス トピース管理テーブル45において管理されている。

【0060】図21に示したテストピース管理テープル 45の上の横軸には、TPを必要とする工程名、TPを 押入する位置、TPの極額、エラーコードが記入されて いる。

【0061】例えば、図22に示したプロセスフロー情 報、すなわち、前洗浄処理、アルミニウム膜を堆積する 工程。膜厚を測定する工程において、本来TPは、前洗 浄処理において挿入し、膜厚を測定する工程において抜 き取るが、この場合は、アルミニウム膜を堆積する工程 でTPを挿入し、膜厚を測定する工程で抜き取っている ので、図21に示したテストピース管理テーブル45に よって、TPの挿入位置が違うという事で、NGである 事がチェックされる。

したテストピース管理テーブル45によってチェックさ れる。すなわち図22に示したプロセスフロー情報にお いて、アルミニウム膜の膜厚を測定するTPは、本来専 用のものを用いなければならないが、回収のTPを用い ているので、図21に示したテストピース管理テーブル 45によってNGである事がチェックされる。

【0063】連続工程チェック部47では、プロセスフ ロー情報に記述されている連続工程(待ち状態となって はいけない工程)の配述方法が正しいかをチェックする 機能を有している。また、このチェックに関するルール 30 は、連続工程管理テーブル49において管理されてい

【0064】図23に示した連続工程管理テーブル49 の上の機軸には、連続工程として考えられる工程の名 称、エラーコードが記入されている。

【0065】例えば、図24に示したプロセスフロー情 報、すなわち、連続開始、前洗浄処理、酸化工程、膜厚 湖定、前洗浄処理、アルミニウム農権積工程、膜厚測 定、連続終了の工程において、本来、連続工程中の前洗 浄処理は、最初のみ必要で、後は必要としないが、図2 40 4に示したプロセスフロー情報では、後すなわち、アル ミニウム膜を堆積する工程の前に前洗浄処理が存在して いるので、図23に示した連続工程管理テーブル49に よってNGである事がチェックされる。

【0066】エラーメッセージ作成部51は、様々なチ エックを行った後で、NGがあった場合、それに見合っ たエラーメッセージを作成する機能を有している。ま た、エラーメッセージに関する情報は、エラーコード管 理テーブル53において管理されている。

12 3には、機軸にエラー番号、エラーメッセージが記入さ れている。

【0068】例えば、図26に示すプロセスフロー情報 すなわち、アルミニウム膜を堆積する工程の前に前洗浄 処理がなかっ場合、本来、アルミニウム膜を堆積する工 程の前には前洗浄処理が必要であるが、この場合存在し ないため、工程順序チェック部36により、工程順序管 理テーブル37においてNGである事がチェックされ、 同時にそのNGに対して図25に示すエラーコード管理 テーブル53において、上記NGに対応するエラーコー ド (この場合"008") に対応するエラーメッセージ 「膜を堆積する工程の前に洗浄処理がありません」が作 成される。

【0069】結果出力部55は、上配チェックを行った 後、間違いが有った場合エラーファイル (エラーメッセ ージをまとめたファイル)を作成し、間違いが無かった 場合は、CAMファイルを作成する機能を有している。

【0070】チェック判断部57は、上紀チェックを行 うか否かについて管理する機能を有している。また、こ 【0062】また、TPの種類についても、図21に示 20 のチェックするか否かの情報は、チェック管理テーブル 59において管理されている。

> 【0071】図27に示すチェック管理テーブル59 は、チェック項目の名称、チェックを行うか否かの情報 が記入されている。例えば図27に示されたテーブルで は、下地状態チェック以外は行うことを示している。こ れによって、必要の無いチェックを省略する事が可能と なる.

【0072】次に本発明の具体的な実現手段について、 再度図1を参照しながら説明する。フロー取込み部1、 分割情報取込み部3、マスク情報取込み部7、各チェッ ク部11~47、エラーメッセージ作成部51はCPU に付属するメインメモリで実現されている。

【0073】各管理テーブル5~53はハードディス ク、あるいはフロッピーディスクなどの記録媒体に保存 されている。何えば、記憶媒体に保存された各管理テー プル5~53は、チェック開始時に前配メインメモリに 呼び込まれ、CPUによるソフトウエア制御のもとに各 チェック部11~47、エラーメッセージ作成部51が 時間をおって、CPUに付属する前記メインメモリ内で チェック判断部57、チェック管理テーブル59を参照 して順次実現される。

【0074】チェック結果は、チェック時にエラーが発 生した場合は、エラーメッセージ作成部51、エラーコ ード管理テーブル 5 3 によってエラーファイルが、プリ ンター、もしくは、配像媒体に出力される。

【0075】次にこの発明における製造規則チェックシ ステムの作用について述べる。

【0076】フロー取込み部1では、配憶装置、例えば ハードディスク、フロッピーディスク等にあらかじめス 【0067】図25に示すエラーコード管理テーブル5 50 クリーンエディタ等で作成されたプロセスフロー情報を

コンピュータのメインメモリー上に取込む。そのプロセ スフロー情報の一例を図28に示す。同図には、コード 群が、処理工程順に記述されている。なお、プロセスフ ローデータの1行が、1工程に相当する。

【0077】次に、分割情報生成システム2において、 メインメモリに取込まれたプロセスフロー情報に、ロッ ト分割工程が存在するかどうかのチェックが行われる。 ロット分割工程が存在した場合は、そこに書かれている 分割数、各々の分割枚数、分割製品番号によって、どの 製品がどの分割プロセスフロー情報を用いるかによって 10 分類を行い、更に同一プロセスフローで処理される製品 を単位として製品番号のグルーピングを行う。

【0078】この結果、すなわちどの製品がどの分割プ ロセスフロー情報を使用するかは、分割情報管理テープ ル5において管理される。この作業を行う事によって、 分割工程を含まないプロセスフロー情報を作成する事が でき、チェックにはこのプロセスフロー情報を用いるの で、プロセスフローチェックシステムが大幅に間略化で きる。

【0079】レイア情報生成システム6で、プロセスフ 20 ローのリソグラフィ工程で用いられるマスクパターンの 寸法データ、およびリソグラフィ工程でレジストが残る か否かのレジスト情報を、そのプロセスフローで用いら れる全てのマスクパターンについて取得し、パターンの 重なる部分、重ならない部分のグルーピングを行い新た にレイア情報管理テーブル9を作成する。このレイア情 報のレイア数は、鉄橋浩管理テーブル13に用いられ 3.

【0080】次に分割情報生成システム2によって新た ~47、及び各管理テーブル13~49によってチェッ クを行う。ここでは、図28に示したプロセスフロー情 報の5番目の工程がチェックされる場合を考える。

【0081】まず膜構造チェック部11において、エッ チング工程に書かれている削る膜の構造と膜構造管理テ ープル13で管理されている製品上に堆積されている膜 の構造が等しいかどうかのチェックを行う。ただし、図 28に示したプロセスフロー情報内にはエッチング工程 が存在しないので、チェックは省略される。

【0082】表面状態チェック部15では、膜構造管理 40 テーブル13より製品の表面に存在する膜、及び5番目 の工程の情報をプロセスフローより取込み、5番目の工 程が、製品表面に存在する膜によって、行えるか否かに ついて、表面状態管理テーブル17を用いてチェックさ

【0083】裏面状態チェック部19において、膜構造 **管理テーブル13より、製品裏面に存在する膜、及び5** 番目の工程の情報をプロセスフローより取込み、5番目 の工程が、製品裏面に存在する膜によって、行えるか否 かについて、裏面状態管理テーブル21を用いてチェッ 60 をする事ができる。

クされる.

【0084】下地状態チェック郁23において、膜構造 管理テープル13より製品上に存在している全ての膜、 及び5番目の工程の情報をプロセスフローより取込み、 5番目の工程が、製品の表面上に存在する膜によって、 行えるか否かについて、下地状態管理テーブル25を用 いてチェックを行う。

【0085】拡散状態チェック部27において、番号5 で用いられた拡散炉と番号16で用いられる拡散炉とを 比較して、製品が汚染された拡散炉から、綺麗な拡散炉 に入ることを防ぐチェックを拡散状態管理テーブル29 を用いて行う。

【0086】パッケージチェック部31において、5番 目の工程が、ある工程とある工程とのパッケージの中に 存在するかどうかをパッケージ管理テーブル33を用い てチェックする。

【0087】工程順序チェック部35において、5番目 の工程の前後に規定された工程が存在するかどうか、ま たは存在してはいけない工程が存在するかどうかのチェ ックを工程順序管理テーブル37を用いて行う。

【0088】ルーチン外チェック部39において、5番 目の工程が、行ってはいけない工程かどうかのチェック をルーチン外管理テーブル41を用いて行う。

【0089】テストピースチェック部43において5番 目の工程で用いられているテストピーチが正しいもので あるかどうか、テストピースを挿入、抜き取る工程が正 しいかをテストピース管理テーブル45を用いてチェッ クを行う。

【0090】最後に連続工程チェック部47において、 に作成されたプロセスフロー情報を、各チェック部11 30 連続開始、連続終了で囲まれている中に工程の順序が正 しいかどうかを連続工程管理テーブル49を用いてチェ ックを行う。

> 【0091】これら全てのチェックにおいて、NGと初 断された場合、エラーメッセージ作成部51において、 エラーコード管理テープル53を参照してメッセージが 作成され、結果出力部55より外部記憶装置に出力され る。NGがまったく存在しなかった場合は、約果出力部 55よりCAMファイルが外部配修装置に出力される。

【0092】また、チェック判断部57、チェック管理 テープル59によって、今まで述べたチェックを行う か、行わないかの選択ができる。

【0093】このように、この発明の製造規則チェック システムでは、各管理テーブル13~49を用いて工程 順に記述されたプロセスフローを高速にチェックを行う 事ができる。例えば、人間では300工程の処理フロー をチェックするのに約30分かかるところをこのチェッ ク装置では約1/10以下でチェックすることができる ようになった。また、これらのチェックは行わない事も できる。ただし、それについてはシステム管理者が設定

【0094】次に、前述した図1における分割情報生成 システム2について以下に詳しく説明する。

【0095】図29はこの分割情報生成システム2の機 能プロック図である。同図に示す処理システムは、分割 工程数カウント部63、ロット分割数カウント部65、 製品毎分割工程場合分け部67、グルーピング部69、 フロー生成部71、分割情報管理テープル5から構成さ れている。

【0096】分割工程数カウント部63は、プロセスフ ローにロット分割工程が存在した場合その工程数を数え 10 る。何えば図30に示すプロセスフローにおいて、ロッ ト分割工程が2工程存在しているので、この場合は2と カウントされる。また、図31に図30のロットの流れ の概略図を示す。

【0097】ロット分割数カウント部65では、分割工 程に書かれているロット分割数をメモリ上に取り込む機 能を有している。図30に示すプロセスフローでは、最 初の分割工程では、本体を3つに分割し、2回目の分割 工程では本体を2つに分割することを示している。

【0098】製品毎分割工無場合分け部67では、ロッ 20 ト分割工程に書いてある情報より更に製品番号ごとに、 どの分割工程を用いるかによって場合分けを行う。図3 0に示すプロセスフローでは、1回目の分割では製品番 母1,2は本体、製品番号3,4は分割①、製品番号 5,6は分割②のプロセスフローを用いることを示して いる。2回目の分割では製品番号1、3、5は本体、製 品番号2, 4, 6は分割Oのプロセスフローを用いるこ とを示している。これをまとめたものを図32に示す。

【0099】グルーピング部69では、製品毎分割工程 場合分け部67で得られた情報より、同一プロセスフロ 30 ープル5に格納される。 一情報でグルーピングを行う。グルーピングをした結果 をもとに分割情報管理テーブル5が作成される。図33 に示した分割情報管理テーブルにおいて、図32におい て同一情報が存在しないので、分割パターンはa, b, c, d, e, fの6種類に分割される事がわかる。

【0100】グルーピング部69において、分割情報テ ープル5を用いて、製品毎にプロセスフロー情報を作成 する。図34に示す様に、投入から1回目の分割までを A、1回目の分割において、本体をB、分割①をC、分 割②をD、1回目の分割の合流から、2回目の分割まで の工程をE、2回目の分割において本体をF、分割①を G、2回目の分割から払い出しまでをHとすると、図3 3の分割情報管理テーブルより、フロー生成部71にお いて分割工程を含まないプロセスフローが生成される。 例えば製品番号1は、図35に示す様にA+B+E+F +Hとなる。

【0101】次に、このシステム実現手段について、図 29を参照しながら説明する。分割工程数カウント部6 3、ロット分割数カウント部65、製品毎分割工程場合

CPUに付属するメインメモリで実現されている。

【0102】分割情報管理テーブル5はハードディス ク、あるいはフロッピーディスクなどの配録媒体に保存 されている。

【0103】例えば、CPUに付属するメインメモリ上 で、分割工程数カウント部63、ロット分割数カウント 部65、製品毎分割工程場合分け部67、グルーピング 部69が時間をおって実現される。その結果は、分割情 報管理テーブル5に出力され、フロー生成部71で分割 管理テーブル5を参照して分割工程を含まないプロセス フローが配位媒体に出力される。

【0104】次にこの分割情報生成システムの作用につ いて述べる。

【0105】まず、分割工程数カウント部63におい て、フロー取り込み部1によってメインメモリに取り込 まれたプロセスフロー情報に、ロット分割工程が存在す るかどうかのチェックが行われる。ロット分割工程が存 在した場合は、そのロット分割工程数を数える。ここ で、分割工程が1つも存在しなかった場合は、この分割 情報取り込み部で行われる作業は終了する。

【0106】次にロット分割数カウント部65におい て、各々の分割工程内にある製品分割数を数える。

【0107】次にロット分割工程に書かれているロット 分割の内訳(各々の分割枚数、分割製品番号)によっ て、どの製品がどの分割のプロセスフロー情報を用いる かによって分類を行い、グルーピング部69において同 ープロセスフロー情報単位で製品番号のグルーピングを 行う。

【0108】このグルーピングの結果は分割情報管理テ

【0109】次にフロー生成部において、分割情報管理 テープル5を用いて、どの製品がどの分割プロセスフロ 一情報を使用するかによって分割工程を含まないプロセ スフローを作成する。チェックにはこのプロセスフロー 情報を用いる。

【0110】すなわち、この分割情報管理システムを用 いればプロセスフローに分割工程が存在していてもあた かも分割工程が存在しないかの様に是非の判断をコンピ ュータにより行うことが可能となる。これにより、プロ セスフローのチェックに際しては分割の事を考慮にいれ る必要がないのでチェックシステムを大幅に簡略化する 事ができる。

【0111】次に、前述した図1におけるレイア情報生 成システム6の詳細について以下に説明する。

【0112】図36は、レイア情報生成システム6の機 能ブロック図である。

【0113】レイア情報生成システム6は、マスク情報 取込み部7、マスク情報管理テーブル9、レイア情報生 成部101、機能選択部103, レイア情報受渡し部1 分け部67、グルーピング部69、フロー生成部71は 50 05から構成されている。またマスク情報生成システム

6は、マスク情報生成部107、CADシステム10 9、チェックシステム10,シミュレーションシステム 111、他システム113と接続されている。

【0114】CADシステム109は、一般に市販され たり、各企業にて開発されたレイアウト設計システムで あり、その特殊性は問わない。このCADシステム10 9にてマスク情報の長さや面積等の情報を生成する。例 えば、半導体製造におけるマスクレイアウトを例に取る と、図37(a)に示す様な設計図を作成することがで . きる.

【0115】この図37 (a) の例では、マスク1では 1本の線を、マスク2では2本の線、マスク3では2個 の穴を表している。

【0116】この様に半導体製造の場合、このマスク情 報が複数存在し、その図の形や長さはまちまちである。 また、半導体製造の場合には、図37(a)に示す風強 の部分には、レジストが残るか否かの情報が付帯してい る。つまり、半導体製造を例に取ると、CADシステム 109では、マスク情報、例えば「長さ」と「レジスト 有無」を生成する。ただし、この情報は、設計関節の前 20 積などであっても良い。

【0117】マスク情報生成部107は、CADシステ ム109で生成された情報を次の機能部へ転送するため に加工する部分である。例えば、上記半導体製造の例を 取ると、CADシステム109で生成されたマスクの 「長さ」情報と「レジスト有無」情報は、このマスク情 報生成部107にて英数字の形に変換される。

【0118】図37 (a), (b)を参照して、CAD システム109での図形情報、例えばマスク1のある1 次元部分(図37(a)の一点破線)のマスクの「長 30 さ」情報は、『a1, a2, a3』と表され、一方、 「レジスト有無」情報は、レジスト「有り」を「1」、 「無」を「0」とすると、「0、1、0」で表される。 、つまり、マスク情報生成部107は、CADシステム1 09で指定された場所からマスクの「長さ」情報と「レ ジスト有無」情報、『a1, a2, a3/0、1、0』 を生成する機能を有している。

【0119】図37 (b) に図37 (a) から変換され たこれらの情報のイメージを示す。マスク情報生成部1 る。ここで、マスクの情報を収集したい部分の指定は、 例えばマウス等の入力媒体を使用することにより指定す ることができる。マウスをマスク形状のある任意の一点 に移動しクリックすることで、全てのマスクの同一位置 の情報を得ることができる。図37の例を参照すると、 マスク1の一点破線のいかなる部分をクリックすること で、マスク2、3・・・の同一位置の情報を収集でき

【0120】上記の例ではマスク情報の1次元に対応し

能である。

【0121】マスクの「長さ」情報や、「レジスト有 無」情報の場所を指定する場合、マスク上にある1点を 指定したが、この指定方法を任意の原点から、任意のス テップにより、ずらして指定することで概2次元の「長 さ」情報や、「レジスト有無」情報を指定することがで

18

【0122】具体的には、図38(a)に示す様に、任 意に原点〇を指定し、ステップも任意に指定すること 10 で、「長さ」情報が『a1、a2、a3』、『b1, b 2, b3」、「c1, c2, c3」とずれて指定でき る。これらの情報をマスク情報生成部107において例 えば、図38(b)に示す様にマトリックスとして生成 することができる。

【0123】上配のように生成されたマスクの「長さ」 情報や、「レジスト有無」情報は、レイア情報生成シス テム6内の配録媒体に格納される。

【0124】マスク情報取込み部7は、上記マスク情報 生成部107の情報を配録媒体から取り出し、マスク情 報管理テーブル9に展開した後、レイア情報生成部10 1へ受け渡す部分である。

【0125】レイア情報生成部101は、マスク情報生 成部107にて生成された情報から、「レイア情報」と 呼ばれる情報を生成する部分である。具体的に、図30 (b), (c)を参照してこのレイア情報生成部101 について解説する。

【0126】マスク情報生成部107にて生成された情 報、すなわち図37(b)におけるマスク1の情報は、 図37(c)では3つの部分(a1~a3)に分けるこ とができる。この1つ1つの部分がレイアと呼ばれる情 報であり、マスクが1枚の場合には、マスク情報とレイ ア情報は同じである。ちなみに、マスク1枚の時のレイ ア情報は3レイアで長さとレジスト有無情報はそれぞれ 「a1, a2, a3/0、1、0」である。

【0127】次にマスク2をマスク1に重ね合わせる と、レイアは図37 (c) の如く5レイア (b1~b 5) となる。さらに、マスク3を重ね合わせると、レイ ア数は9レイアとなる。この時長さは、レイア (1) " はc1であるが、レイア (2) "は (b1-c1)、レ 07は、図37(a)から(b)への変換を行ってい 40 イア(3) "は((c1+c2)-b1)等となり、レ ジスト有無情報もそれぞれ「0、1、1・・・・」と なる。

> 【0128】この様に、レイア情報生成部101では、 マスク情報生成部107から渡されたマスク情報を上記 例の示す様なレイア情報に変換する部分である。この時 マスク枚数は、何枚あっても構わない。つまり、レイア 情報生成部101は、図30(b)の情報を(c)の情 報へと変換する機能を有している。

【0129】機能選択部103は、レイア情報生成部1 ているが、次の方法を採用することで2次元にも対応可 50 01で生成された清報を図1で示したチェックシステム フロー情報。

10、シミュレーションシステム111、あるいは他システム113等へ転送する場合の選択機能を有している。

【0130】レイア情報受波し部105は、上配機能選択部103で選択されたいずれかのシステムヘレイア情報を受波す部分である。

【0131】なお、シミュレーションシステム111 は、プロセス/デバイス/形状シミュレータに代表され るシミュレーションシステムである。他システム113 は、上記システム以外のレイア情報を必要とするシステ 10 ムである。

[0132]

【発明の効果】以上述べたように、本発明による製造規 則チェックシステムでは、プロセスフロー情報のチェッ 、クをコンピュータにより自動的に行うことが可能とな る。これにより、誰でもが簡単に共通の知識として利用 できるようになるとともに、チェックのミスが減少す る。

【0133】さらに、本発明による製造規則チェックシステムによれば、プロセスフロー情報にマスク情報が付 20 加されていることから、プロセス/デバイス/形状シミュレータへ2次元、3次元情報を自動転送することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例における製造規則チェックシ ステムのハードウェア構成。

【図2】膜構造チェック部を説明する為のプロセスフロー情報。

- 【図3】膜構造管理テーブル。
- 【図4】臓構造管理テーブル。
- 【図5】表面状態管理テーブル。
- 【図6】膜Aが製品の表面に堆積されている時に処理 a、処理bを行う場合の概念図。
- 【図7】膜A、膜Bが製品の表面に堆積されている時に 処理a、処理bを行う場合の概念図。
- 【図8】裏面状態管理テーブル。
- 【図9】膜Cが製品の裏面に堆積されている時に処理 a、処理bを行う場合の概念図。
- 【図10】下地状態管理テーブル。
- 【図11】膜A、B、Cが製品表面に堆積されている時 40 に処理bを行う場合の概念図。
- 【図12】拡散状態管理テーブル。
- 【図13】拡散炉Dに入った製品が、拡散炉E、Fに入る場合の概念図。
- 【図14】パッケージ管理テーブル。
- 【図15】パッケージチェック部を説明する為のプロセスフロー情報。
- 【図16】パッケージチェック部を説明する為のプロセスフロー情報。

【図17】工程順序管理デーブル。

20 【図18】 工程順序チェック部を説明する為のプロセス

【図19】ルーチン外管理テーブル。

【図20】ルーチン外チェック部を説明するためのプロセスフロー情報。

【図21】テストピース管理テーブル。

【図22】テストピースチェック部を説明するためのプロセスフロー情報。

【図23】連続工程管理テーブル。

【図24】連続工程チェック部を説明するためのプロセスフロー情報。

【図25】エラーコード管理テーブル。

【図26】エラーメッセージ作成部を説明する為のプロセスフロー情報。

【図27】チェック管理テーブル。

【図28】 人手で作成したプロセスフロー情報。

【図29】図1で示した分割情報生成システムのハードウェア構成。

【図30】ロット分割工程を含んだプロセスフロー情報。

【図31】図30のロットの流れを示す概略図。

【図32】製品番号ごとにどの分割工程を用いるかを管理する概念図。

【図33】図32を同一分割情報でパターン分けを行った結果を管理する概念図。

【図34】プロセスフローをパターン分けした概略図。

【図35】製品番号1の分割工程を含まないプロセスフローの概略図。

【図36】図1で示したレイア情報生成システムの詳細 30 な機能プロック図。

【図37】レイア情報生成システムによるマスク情報からレイア情報への生成イメージ図。

【図38】レイア情報生成システムによるマスク情報から2次元レイア情報への生成イメージ図。

【図39】従来用いられていたプロセスフローの一例。 【符号の説明】

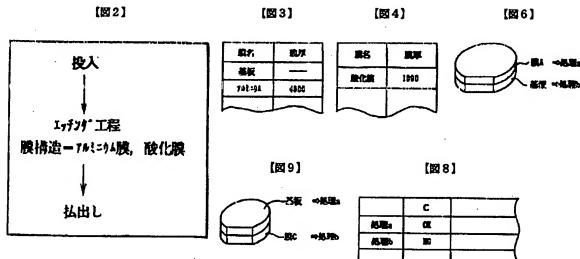
- 1 プロセスフロー取込み部
- 2 分割情報生成システム
- 3 分割情報取込み部
- 5 分割情報管理テープル
- 6 レイア情報生成システム
- 7 マスク情報取込み部
- 9 マスク情報管理テーブル
- 10 チェックシステム
- 11 膜構造チェック部
- 13 膜構造管理テーブル
- 15 表面状態チェック部
- 17 表面状態管理テーブル
- 19 裏面状態チェック部
- 50 21 裏面状態管理テーブル

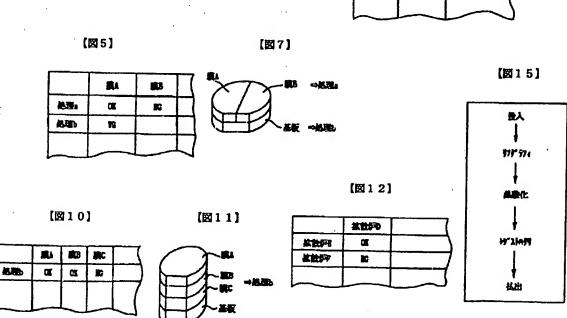
--539---

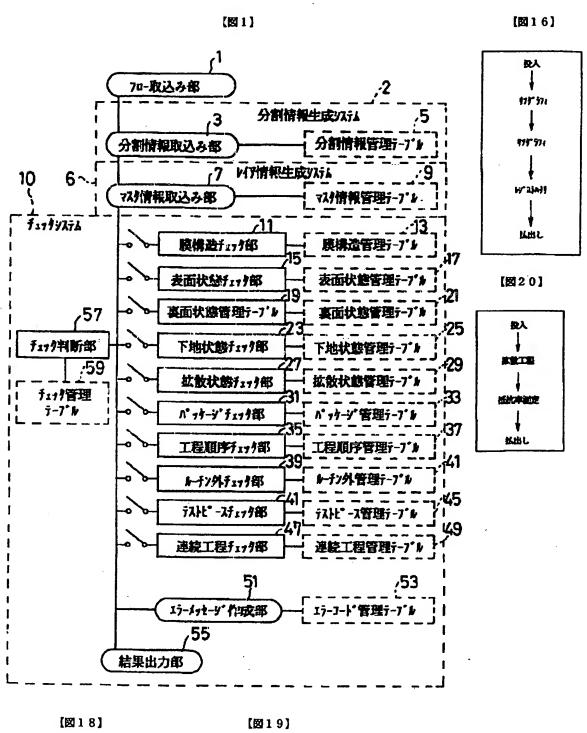
- 23 下地状態チェック部
- 25 下地状態管理テーブル
- 27 拡散状態チェック部
- 29 拡散状態管理テープル
- 31 パッケージチェック部
- 33 パッケージ管理テープル
- 35 工程順序チェック部
- 37 工程順序管理テーブル
- 39 ルーチン外チェック部
- 41 ルーチン外管理テーブル
- 43 テストピースチェック部
- 45 テストピース管理テーブル
- 47 連続工程チェック部
- 49 連続工程管理テーブル

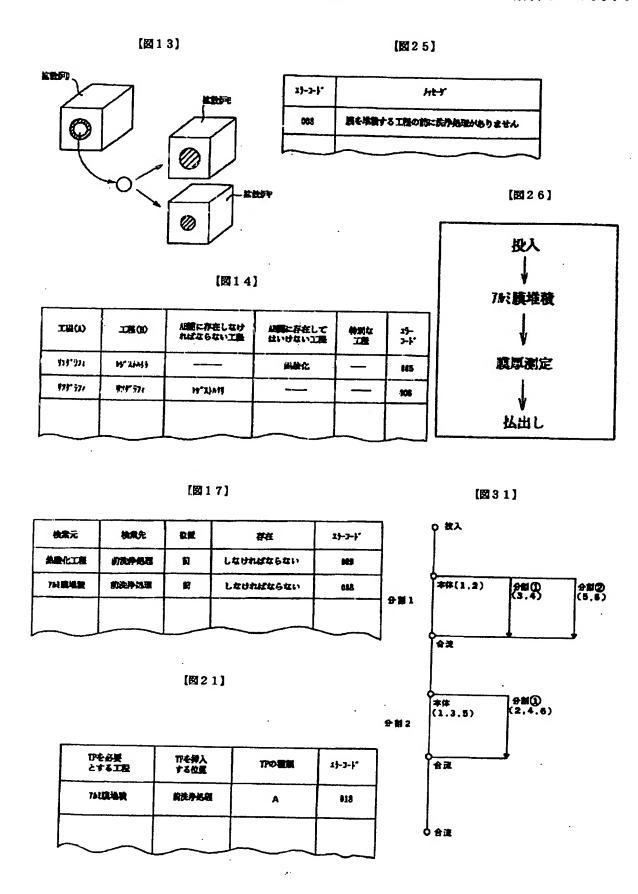
51 エラーメッセージ作成部

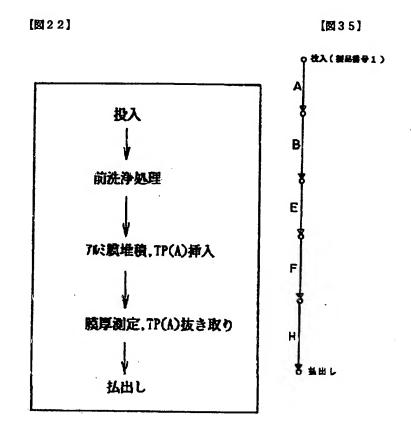
- 55 結果出力部
- 57 チェック判断部
- 59 チェック管理テーブル
- 63 分割工程カウント部
 - 65 ロット分割数カウント部
 - 67 製品每分割工程場合分け部
 - 69 グルーピング部
 - 71 フロー生成部
- 10 101 レイア情報生成部
 - 103 機能選択部
 - 105 レイア情報受波し部
 - 107 マスク情報生成部











【図23】

| IMS | IRS | INS | 工程名 | 工程名 | 工程名 | 工器名 | ジー ア・ド |
|------------|--------|-----|-----|-------|--------------|-----|-----------|
| 連算場 | REPAIR | 酰化 | | 7段調準機 | 原學 就定 | #T | EAA |
| | | | | | | | |
| | لــــا | | | | | | L, |

【図24】

【图27】



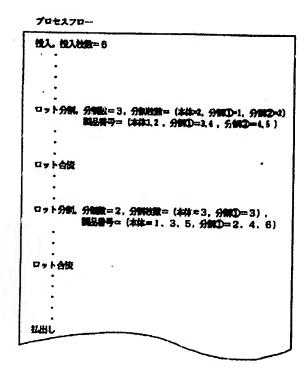
| fzyf都名 | f11/する か否か |
|------------------|---------------|
| 表面状態5.17部 | する |
| 美面状態fzzf部 | する |
| 下地状態行功的 | 否 |
| | |
| | |

[図32]

| 分類工程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|---|---|---|-----|---|---|
| 1 9 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 2 2 | 0 | θ | 0 | .00 | 0 | 0 |

[图28]

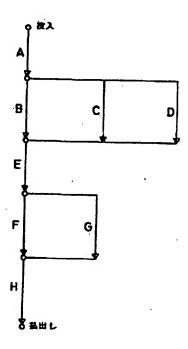
[図30]



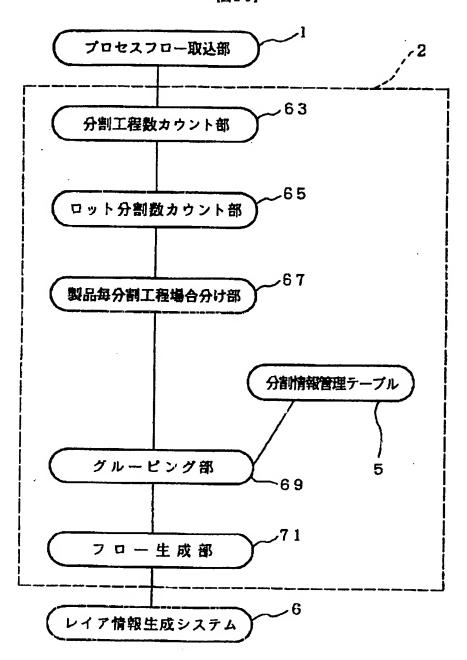
[2333]

| 分類工程 分類工程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 2 3 | 0 | 0 | θ | 0 | • | 0 | |
| 2 🖪 🗒 | 0 | θ | 6 | θ | 9 | Θ | |
| パターン | a | Ъ | С | d | 0 | t | |

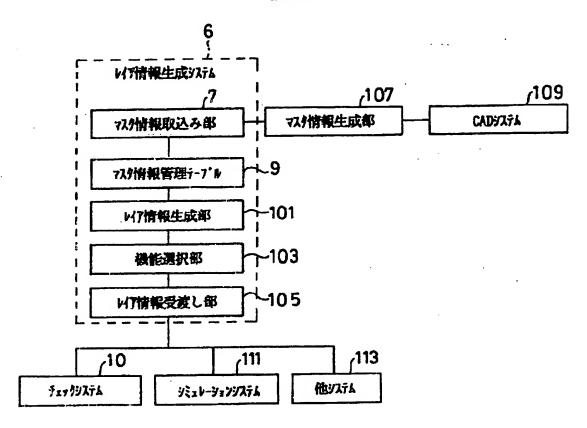
[図34]



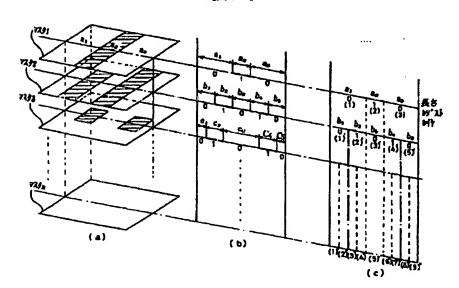
【図29】



[图36]



【図37】



[图 3 8]

[图 3 9]

[图 3 9]